

SUB-D STECKVERBINDER

Einpreßtechnik

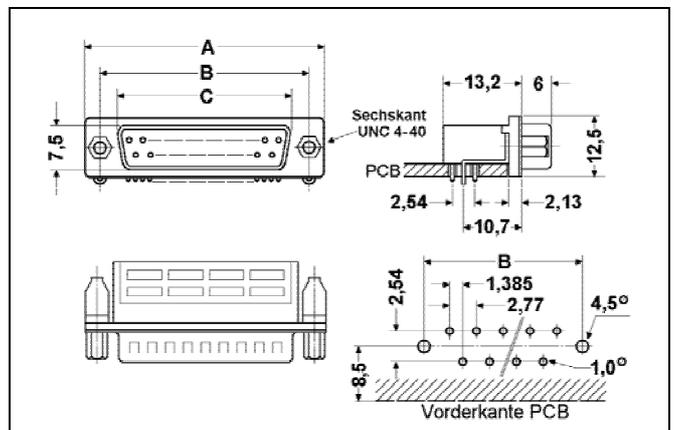
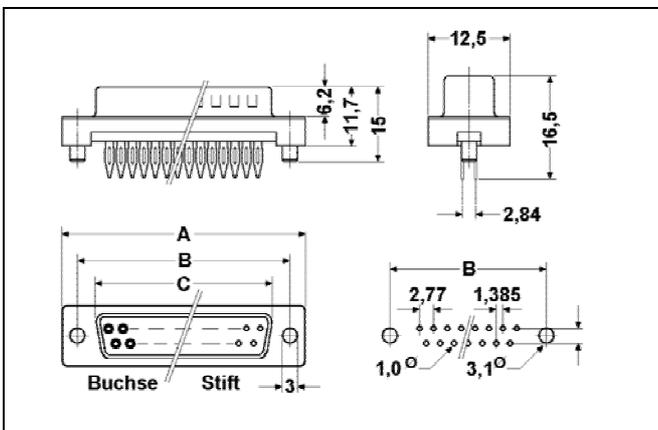
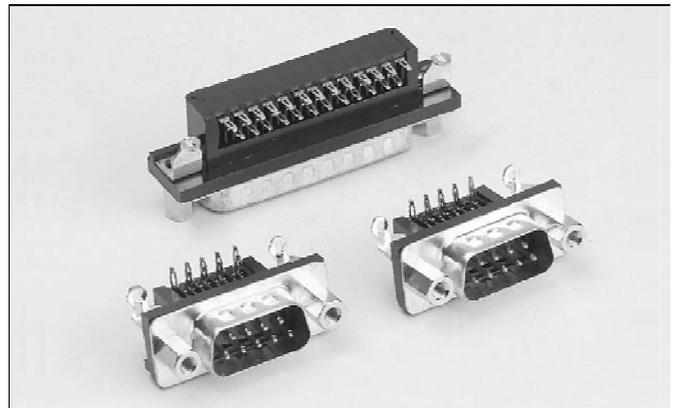
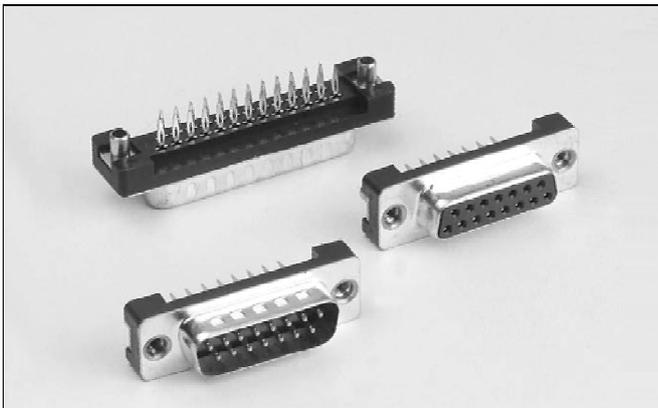
Steckverbinder in Einpreßtechnik sind eine praktische Lösung zur nachträglichen Montage von SUB-D Steckverbindern auf Leiterplatten in SMD-Technik.

Diese sind in gerader und abgewinkelter Ausführung von 09 bis 37polig lieferbar und sind mit flachem Einpreßstempel leicht in die Leiterplatte zu verpressen.

Die elastische Einpreßzone gewährleistet höchste Kontakt-sicherheit auch bei hohen Toleranzen der Montagebohrung von 1,0mmØ in der durchkontaktierten Leiterplatte.

Technische Daten:

Gehäuse:	Stahl, verzinkt
Kontaktmaterial:	Phosphorbronze
Kontaktoberfläche:	vergoldet über Nickel
Isolierkörper:	PBT, 30% GV, UL 94 V-0
Nennstrom:	5 A
Prüfspannung:	> 1000 V für 1 Minute
Temperaturbereich:	-55°C bis +105°C



DC310 - XX / XXX

Serie: **DC310** SUB-D Steckerleiste, **gerade**, Einpreßtechnik mit „Boardlock-Befestigung“

Polzahl / Stift:	01/09M 09pol. Stift
	02/15M 15pol. Stift
	05/25M 25pol. Stift
	06/37M 37pol. Stift
Polzahl / Buchse:	11/09F 09pol. Buchse
	12/15F 15pol. Buchse
	15/25F 25pol. Buchse
	16/37F 37pol. Buchse

Variante: **A** Befestigungsart
B Zubehör

DC320 - XX / XXX

Serie: **DC320** SUB-D Stiftleiste, **90° abgew.**, Einpreßtechnik, Boardlock und Sechskant, niedrige Bauform

Polzahl / Stift:	01/09M 09pol. Stift
	05/25M 25pol. Stift
Polzahl / Buchse:	

Variante: